



Grade No. : PC P510GSF

Injection Molding Polycarbonate Resin

● 용도(Application) : Monitor Guide Panel

● 특징(Features) : TCO용 Halogen Free Flame Retardant

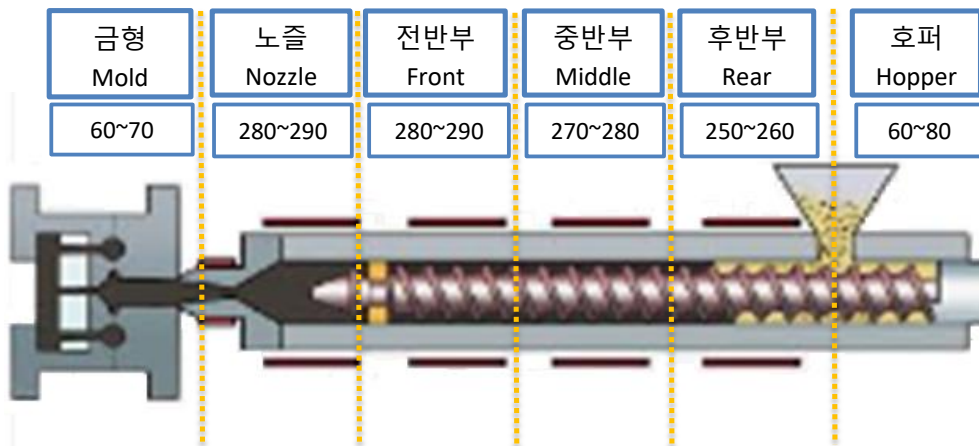
기술자료(Technical Data Sheet)

구분(Division)	조건(Condition)	규격(Test Method)	단위(Unit)	대표값(Value)
물리적 특성(Physical)				
비 중(Density)		ASTM D792	-	1.20
유동성(Melt Flow Index)	300℃/1.2Kg	ASTM D1238	g/10min	20
수축률(Mold Shrinkage)	3.2 mm	ASTM D955	%	0.5~0.7
기계적 특성(Mechanical)				
충격강도(IZOD Impact Strength)	(23℃, Notched)	ASTM D256	kg·cm/cm	65
인장강도(Tensile Strength)	50mm/min	ASTM D638	kg/cm ²	600
신율(Elongation)	50mm/min	ASTM D638	%	100
굴곡강도(Flexural Strength)	10mm/min	ASTM D790	kg/cm ²	700
굴곡탄성률(Flexural Modulus)	10mm/min	ASTM D790	kg/cm ²	22,000
열적 특성(Thermal)				
열변형온도(Heat Deflection Temperature)				
	4.6 kgf/cm ²	ASTM D648	℃	-
	18.6 kgf/cm ²	ASTM D648	℃	125
난연성(Flammability)				
	1.6 mm	UL 94	Class	V-0
	3.2 mm	UL 94	Class	V-0

주) 상기 항목의 값은 제품에 관한 일반적인 정보를 제공하여 고객의 소재 선정 편의를 위한 참고 치수로서 실제와 차이가 있을 수 있으며, 소송 등 법적 분쟁의 근거 자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다.

Notes) These are just typical properties, not specifications. Users should confirm results by their own test.

성형 조건(Molding Condition)



사출성형 가이드(Injection Guide)

		단위 (Unit)	대표값 (Value)
노즐 온도(Nozzle Temperature)	-	℃	280~290
바렐 온도(Barrel Temperature)	전반부(Front)	℃	280~290
	중반부(Middle)		270~280
	후반부(Rear)		250~260
호퍼(Hopper)	-	℃	60~80
금형 온도(Mold Temperature)	-	℃	60~70
건조 조건(Drying Condition)	제습방식 (Dehumidifying method)	℃	100~110
		Hr	2~4
	열풍방식 (Hot Air method)	℃	100~110
		Hr	2~4
건조후 수분율(Moisture Content)	-	%	>0.05

주의 사항(Customer Notice)

상기 언급된 성형조건은 일반적인 권장 조건입니다. 상기 조건은 박막 사출이나 가스 사출등과 특이 조건에 부합되지 않을 수 있으며 기기 특성에 따라 일부 조정이 필요할 수 있습니다.

This documentation is made out based on our tests and experiments in our R&D center with piled up experience and knowledge. And the values are measured on injection molded test specimens. It is suggested that this information contained in this document can be used for general indication. Therefore, you should construe it as product specifications, and you should do appropriate test before you considering your conditions for newly applications.